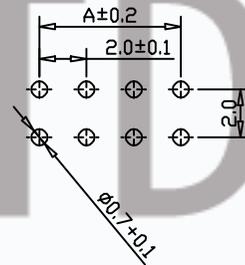
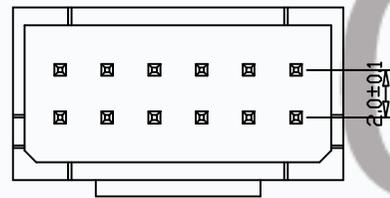
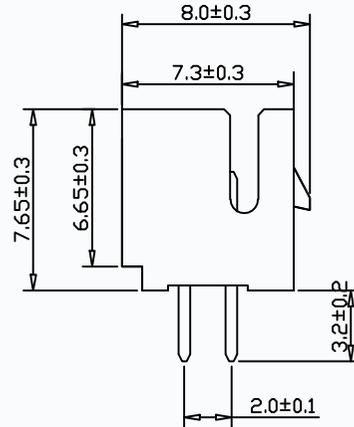
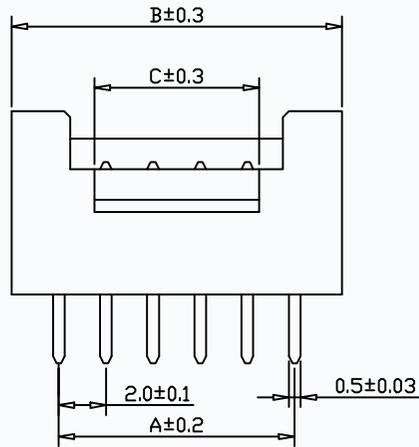


标记	处数	更改前内容	更改后内容	签名	年.月.日



孔位	尺寸(mm)		
	A	B	C
2×2	2.00	6.00	3.00
2×3	4.00	8.00	3.00
2×4	6.00	10.00	3.00
2×5	8.00	12.00	5.00
2×6	10.00	14.00	7.00
2×7	12.00	16.00	9.00
2×8	14.00	18.00	11.00
2×9	16.00	20.00	13.00
2×10	18.00	22.00	15.00
2×11	20.00	24.00	17.00
2×12	22.00	26.00	19.00
2×13	24.00	28.00	21.00
2×14	26.00	30.00	23.00
2×15	28.00	32.00	25.00
2×22	42.00	46.00	39.00

使用温度范围 (Ambient temperature Range): -25°~+85°

适用线规 (Applicable Wires): AWG 28#~22#

适用基板厚度 (Applicable PCboard thickness): 1.6mm

额定电压 (Voltage rating): 250V AC, DC

额定电流 (Current rating): 3A

接触电阻 (Contact Resistance): <0.02Ω

绝缘电阻 (Insulation Resistance): >1000MΩ

耐压 (Withstand Voltage): 800V/min

材料 (Material)

1. 基座: PA66 94V-0

范围	>0-3	>3-18	>18-50	>50-100
公差	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5

未注公差		材料	PA66 94V- 2 (0) or ul		
尺寸范围	公差	比例	1:1	设计/日期	审核/日期
>20	±0.3	版次			
10-20	±0.25	重量		第1页 共1页	初始日期
3-10	±0.2				2019-06-08
<3	±0.1				
T19-200BFL-*A 系列		CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司 Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.			